

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2018-60

天津中环半导体股份有限公司 关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院微电子研究所（以下简称“中科院微电子所”）、北京海淀科技园建设股份有限公司（以下简称“海科建”）、天津滨海高新技术产业开发区塘沽海洋高新技术开发区管理委员会（以下简称“海洋高新区管委会”）就联合在塘沽海洋高新区投资建设高端半导体产业园区合作事宜，签署了《高端半导体产业园区战略合作框架协议》，详见公司刊载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署高端半导体产业战略合作框架协议的公告》（2018-19）。

根据公司战略发展规划，为积极发展半导体产业并投资建设高端半导体产业园区项目，公司拟与海科建、中科院微电子所子公司北京中科微投资管理有限责任公司（以下简称“中科微投”）、天津滨海高新技术产业开发区塘沽海洋高新技术开发总公司（以下简称“海洋高新”）共同投资组建天津中科环海产业园有限公司（以下简称“中科环海产业园”），负责园区运营管理、动力、物业配套及园区招商、产业孵化等。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资组建天津中科环海产业园有限公司的议案》，同意公司与海科建、中科微投及海洋高新共同投资组建中科环海产业园。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1、中科微投是中科院微电子所旗下全资投资管理公司，成立于 2011 年。中科院微电子所是国内微电子领域学科方向布局最完整的综合研究与开发机构，是中国科学院 EDA 中心、中国科学院物联网研究发展中心的依托单位，国家科技重大专项集成电路装备及工艺前瞻性研发牵头组织单位，中国科学院大学微电子学院（国家示范性微电子学院）的依托单位。现拥有 2 个基础研究类中国科学院重点实验室，4 个行业服务类研发中心，5 个行业应用类研发中心，3 个核心产品类研发中心。

2、海科建于 2000 年注册成立，注册资本 6 亿元人民币，主要承担了中关村科技园区北部园区的开发建设等工作，投资的园区主要有中关村软件园、中关村生命科学园等。近两年，与山东济宁经济开发区管委会合作负责该开发区的规划设计、招商运营管理等工作。在“大众创业、万众创新”的时代背景下，投资建设运营了中关村京港澳青年创新创业中心。

3、海洋高新是由天津滨海高新技术产业开发区塘沽海洋高新技术开发区管委会（以下简称塘沽海洋高新区）于 1992 年投资成立，截至 2017 年，注册资本达到 37 亿元，总资产约 63 亿元，主要职责是受塘沽海洋高新区管委会委托在开发区域内进行基础设施建设，为园区招商引资服务，同时承担国有资产保值增值的责任，并兼有对外投资的职能。海洋高新位于塘沽海洋高新区，塘沽海洋高新区是天津滨海高新区核心区“一区四园”重要组成部分，是以互联网新一代技术、海洋产业、医疗健康产业及军民融合产业为主导产业的高新技术开发区。

三、投资标的的基本情况

公司与海科建、中科微投及海洋高新共同投资组建中科环海产业园，相关事宜如下：

1、公司名称（拟）：天津中科环海产业园有限公司

2、注册资本（拟）：50,000 万元人民币

3、注册地址（拟）：天津滨海高新技术产业开发区塘沽海洋高新技术开发区

4、经营范围（拟）：商务服务业，科学研究和技术服务业，场地租赁，房地产项目开发、建设，劳动服务，物业管理，餐饮服务，组织文化艺术交流活动等。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准）

5、各方出资情况（拟）：公司拟出资 26,000 万元，占注册资本的 52%；海科建拟出资 14,000 万元，占注册资本的 28%；中科微投拟出资 5,000 万元，占注册资本的 10%；海洋高新拟出资 5,000 万元，占注册资本的 10%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次合作各方共同在塘沽海洋高新技术开发区投资组建中科环海产业园，重点围绕中环股份产业优势以及中科院微电子所的技术优势和专利布局，充分发挥海科建园区建设及运营经验，共同布局面向高端通讯领域的 5G 通讯、微波毫米波通讯等方面的新兴化合物半导体产业。

2、本次投资建设中科环海产业园，作为高端半导体产业技术研发制造平台，引进及培养高端半导体专业技术人才，共建高端半导体领域的产业高地、研发高地、人才聚集高地。

3、本次投资建设中科环海产业园，未来将在产业园区内投资建设金刚线切割太阳能单晶硅片新一代智能工厂、功率半导体器件工厂、高速芯片工厂等项目，形成产业聚集效应，打造集单晶硅片制造、智能化装备、新材料研发生产等于一体的产业园。

4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日